43公開 平成1年(1989)11月17日

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-286136

®Int. Cl. 4

識別記号

G 11 B 7/24 B 41 M 5/26

广内整理番号 B-8421-5D

V - 7265 - 2H

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

69発明の名称 光記録媒体の製造方法

> ②1)特 願 昭63-116195

22出 願 昭63(1988)5月13日

@発 明 者 石 橋 神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会

@発 明 者 麓 孝 文

信

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会

补内

@発 明 渚 小 沢 睯 冶 神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富十雷機株式会

补内

勿出 願 人 富士電機株式会社

74代 理 人 弁理士 山口 窭 神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

## 眀

光配録媒体の製造方法 1. 発明の名称

# 2. 特許請求の範囲

1) ブラスチック基板上に下地保護層,記録層, 上部保護層を順次積層した光記録媒体の製造方法 において、プラスチック基板を圧力 5×10<sup>-6</sup> Torr 以下の真空中で脱ガス処理したのち下地保護層を 形成することを特徴とする光記録媒体の製造方法。 3. 条明の詳細な説明

## [ 産業上の利用分野]

この発明は光記録媒体の製造方法に係り、特に プラスチック基板上への下地保護層の形成方法に 関する。

# 〔従来の技術〕

情報化社会への移行に伴い、膨大な情報量を記 録する手段として光記録方式が実用化されつつあ る。特に光ディスクは従来多く用いられてきた磁 気記録媒体に比べ10~100倍の記録密度をもち またヘッドとディスクが非接触であるので長寿命 である等の特徴があり高密度。大容量の配録方式 として期待されている。

この光記録は用途により、再生専用型,追配型, 書換え可能型の3つに分類される。再生専用型は 情報の読出しのみが可能なものであり、すでにコ ンパクトディスクとして広く用いられている。追 記型は情報の記録と読出しが可能であるが、記録 した情報の書換えは不可能なものであり、文書フ ァイル用として実用化されつつある。また書換え 可能型は情報の記録。読出し消去が可能でありコ ンピュータ用データファイルとしての用途が期待 されている。

曹換え可能型については各種の方式が開発中で ある。その中でも「光磁気記録」と「相変化記録」 が最も進んでいるが、両方式とも配録材料や普込 み機構の面でさらに改良の余地が残されている。

このうち相変化記録は、一般にレーザ光を記録 面に集光。加熱しそのパルス出力。継続時間を制 御することにより記録材料の相状態(結晶一非結 晶等)を制御し、それぞれの状態の反射率、透過 率の違いで情報の配録を行うものである。

具体的な相変化型光記録部材の1例を第1図に 示す。

プラスチックスよりなる基板 1 の表面に、スパ ッタリング等の方法により SiO 等よりなる下地保 護層 2 が形成され、その上に配録層 3 が形成され る。その上に上部保護層4が形成される。このよ うに記録層3を保護層2.4によりはさんだ構造 とするのは信号の書込み。消去の際光加熱により 媒体が高温となるがその時の基板材料との反応や 媒体の蒸発。飛散を防止し媒体材料の変質を防止 するためである。 好に結晶一非結晶の変化を利用 する場合、結晶状態の記録層を非結晶とするには レーザ光により一旦溶融する必要があり、保護層 が不可欠とされている。

### [発明が解決しようとする課題]

しかしながらこのような構成の光配録媒体にお いてはプラスチック基板が水分や酸素などの溶存 ガスを含むため、下地保護層を形成する過程でと れらが放出され、下地保護層の密着がわるく、空 気中に放置するとクラックが生じこのクラックを

中の容存ガスは放出され、脱ガスされる。 [実施例]

基板として1 mm 厚のPCを使用する。真空槽中で 排気し、真空度を 5×10-6Torr.以下にする。 PC **基板より水分。酸素が脱ガスされる。脱ガスされ** たPC基板上にRFマグネトロンスパッタ法によ り SiO<sub>2</sub>が 100 nm 厚にスパッタされ下地保護層 2 が形成される。このときアルゴン圧力は 0.01Torr の圧力に調整される。この下地保護層はPC基板 を通して侵入する水分,酸素の記録層への侵入を 防ぐ役目および記録時のレーザ加熱による基板の 熱劣化を防ぐ。次に下地保護層2の上に抵抗加熱 法により Ing Teg 記録層 3 が 1 元蒸着により成膜さ れる。蒸発源温度は 1100℃ で記録層の膜厚は 100

次にこの発明の実施例を図面に基いて説明する。

とのようにして得られた光配録媒体を温度30℃。 4.図面の簡単な説明 湿度 6 0 % の 恒 温 恒 湿 槽 中 に 100 時 間 放 置 し た が 、 クラックの発生もなく、記録再生特性も良好であ

nm である。記録層3の上にはSiOzの上部保護層

4 が 200nm 厚に形成される。

通して空気中の水蒸気,酸素が配録層3に浸入し、 記録層が酸化されるという問題があった。

との発明は上配の点に鑑みてなされ、その目的 はプラスチック基板を脱ガスすることにより、密 滑 強 度 に 優 れ る 光 配 録 媒 体 の 製 造 方 法 を 提 供 す る ことにある。

### [ 課題を解決するための手段]

上記の目的はこの発明によればプラスチック基 板上に下地保護層、記録層、上部保護層を順次積 層した光記録媒体の製造方法において、ブラスチ ック基板 1 を圧力 5×10<sup>-6</sup>Torr 以下の真空中で脱 ガス処理したのち下地保護層2を形成することに より識成される。

真空度は 5×10<sup>-6</sup>Torr 以下にされる。 圧力は低 ければ低い方が良い。

プラスチックとしてはポリメチルメタクリレー ト樹脂 ( PMMA ) , ポリカーボネート樹脂 ( PC), エポキシ樹脂等が用いられる。

## [作用]

上述のような高真空下においてブラスチックス

った。

比較例

比較のため 8×10-6Torr , 6×10-6Torr で基板 の脱ガス処理を行ったがこれらのものは、媒体に クラックが発生し、配鉄層が酸化されてしまい、 情報の記録。再生、消去ができなかった。

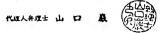
## 「発明の効果」

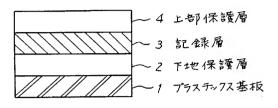
この発明によればブラスチック基板上に下地保 護層。記録層。上部保護層を順次積層した光記録 媒体の製造方法において、プラスチックス基板を 圧力 5×10<sup>-6</sup>Torr 以下の真空中で脱ガス処理した のち下地保護層を形成するのでブラスチックス基 板は脱ガスされた状態で下地保護層が形成され、 その結果密着性の良い下地保護層となってクラッ クが発生せず、記録層の保護が十分となり、信頼 性に優れる光記録媒体を製造することが可能とな

第1図は光記録媒体の模式断面図である。

1 … ブラスチックス基板、 2 … 下地保護層、

3 … 記録層、 4 … 上部保護層。





第1四

**PAT-NO:** JP401286136A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01286136 A

TITLE: MANUFACTURE OF OPTICAL

RECORDING MEDIUM

PUBN-DATE: November 17, 1989

# INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

ISHIBASHI, SHINICHI FUMOTO, TAKAFUMI OZAWA, KENJI

# ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

FUJI ELECTRIC CO LTD N/A

**APPL-NO:** JP63116195

**APPL-DATE:** May 13, 1988

INT-CL (IPC): G11B007/24, B41M005/26

US-CL-CURRENT: 369/283

# ABSTRACT:

PURPOSE: To improve adhesion of base protective layer and to prevent cracks from generating by treating a plastic substrate in vacuum at a specific pressure or below to degas and then forming the base protective layer.

CONSTITUTION: The substrate 1 made of polycarbonate, etc., is evacuated in a vacuum chamber at the pressure of  $\leq 5 \times 10-6$ Torr to remove water and oxygen from the substrate 1. Then SiO2 is deposited on the substrate 1 by RF magnetron sputtering to form the base protective layer 2. Successively, the recording layer 3 and top protective layer 4 are formed on the layer 2. As the layer 2 is formed on the substrate as degased, it shows good adhesion and is free from cracks.

COPYRIGHT: (C)1989, JPO&Japio